

目录

特性参数.....	2
亮度分档.....	2
显指分档.....	2
电压分档.....	2
色区分档.....	3
光电性能特征曲线...4、5	
出货编码规则.....	6
产品尺寸.....	6
包装规格.....	7、8
回流焊曲线.....	9
注意事项.....	10

产品特征

规格: 3.45 mm×3.45 mm
垂直结构陶瓷封装
典型光通量 (25℃)
350mA: 116lm

应用

城市亮化
商业照明
便携式照明

特性参数 ($I_F = 350 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)

项目	单位	最小值	典型值	最大值
发光角度	degrees (°)	--	120	--
反向电压	V	--	--	5
正向电流	mA	--	--	700
正向电压	V	2.8	3.1	3.6
LED 结温	°C	--	--	150

亮度分档 ($I_F = 350 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)

编码	光通量范围(lm)
Q4	87.4~107
Q5	107~114
R2	114~122
R3	122~130
R4	130~139

备注：亮度测试误差±7%

显指分档 ($I_F = 350 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)

编码	典型值
B0	70

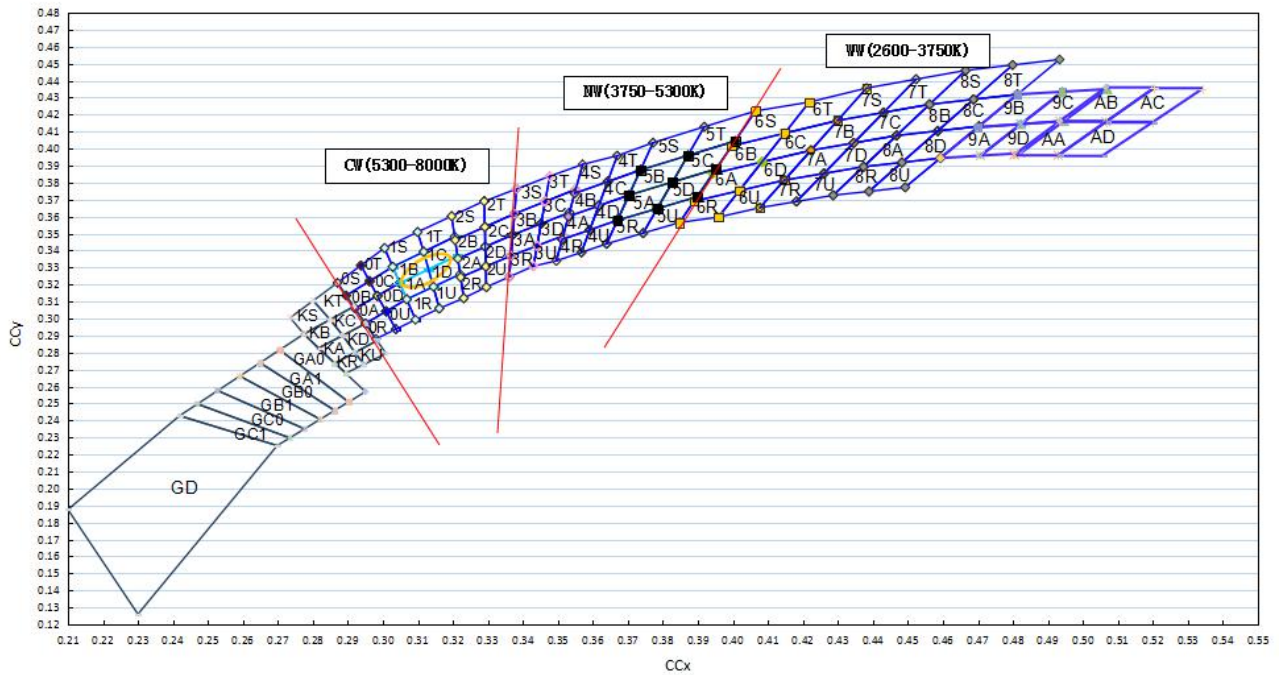
备注：显指测试误差±1

电压分档 ($I_F = 350 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)

编码	电压范围 (V)
V1	2.8~3.0
V2	3.0~3.2
V3	3.2~3.4
V4	3.4~3.6

备注：电压测试误差±0.1V

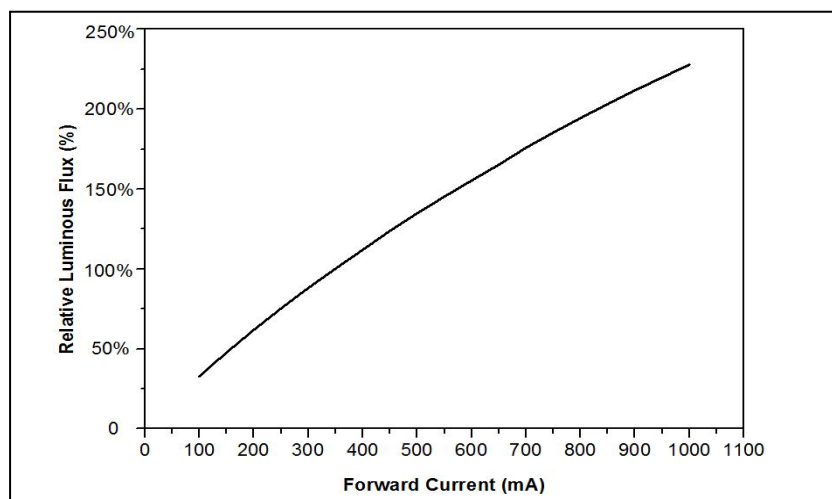
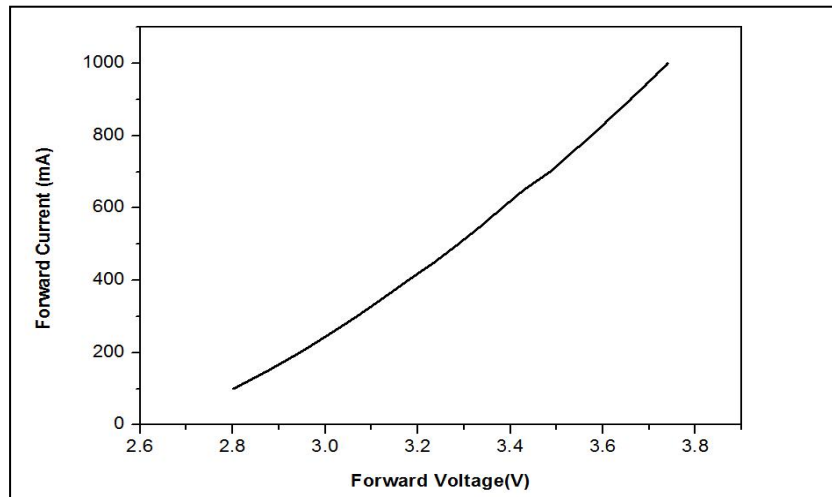
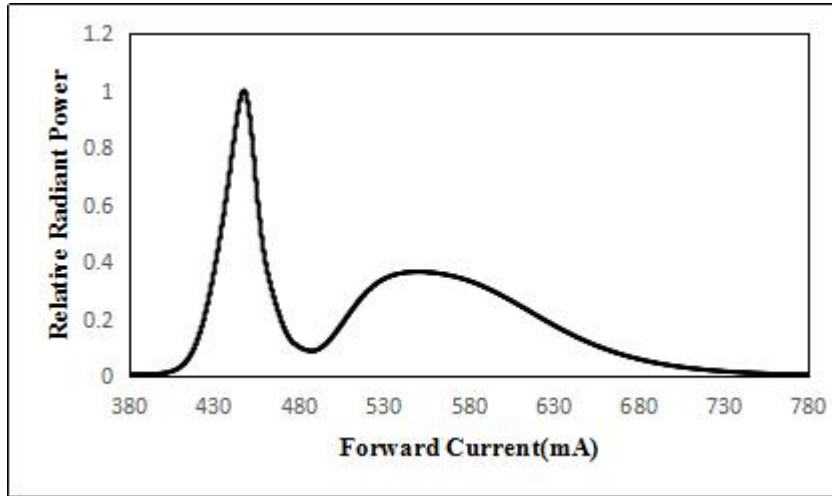
色区分当 ($I_F = 350 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)

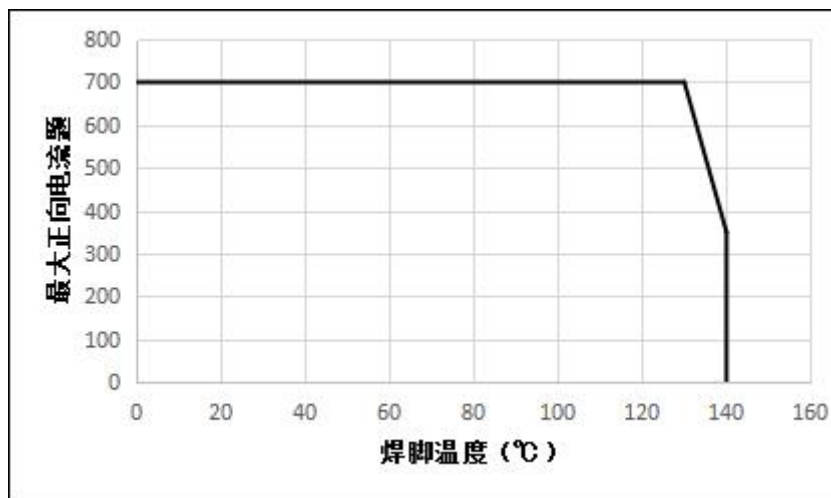
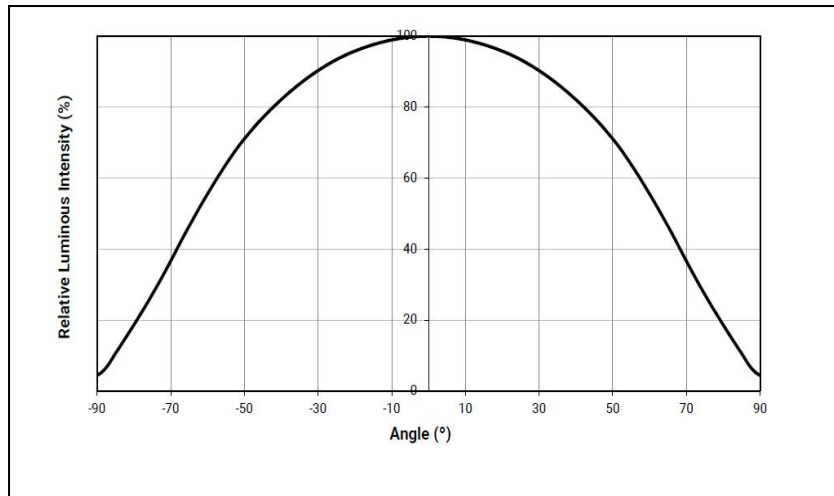


备注：色区 (CCx, CCy) 尺寸误差 ± 0.005

色度 & 色温对照表	
典型色温 (K)	色度区域
5300~5700	2T、2C、2D、2U
5700~6000	2S、2B、2A、2R
6000~6500	1T、1C、1D、1U
6500~7000	1S、1A、1B、1R
7000~8200	0A、0B、0C、0D、0R、0S、0T、0U
8200~9000	KC、KD、KT、KU
9000~10000	KA、KB、KR、KS
10000~11500	GA0
11500~13000	GA1
13000~15000	GB0
15000~18000	GB1
18000~22000	GC0
22000~27000	GC1

光电性能特征曲线 ($I_F = 350 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)





出货条码规则

SSS-SSS-HH-HH-HH-HH

产品类型

显指R

色区W

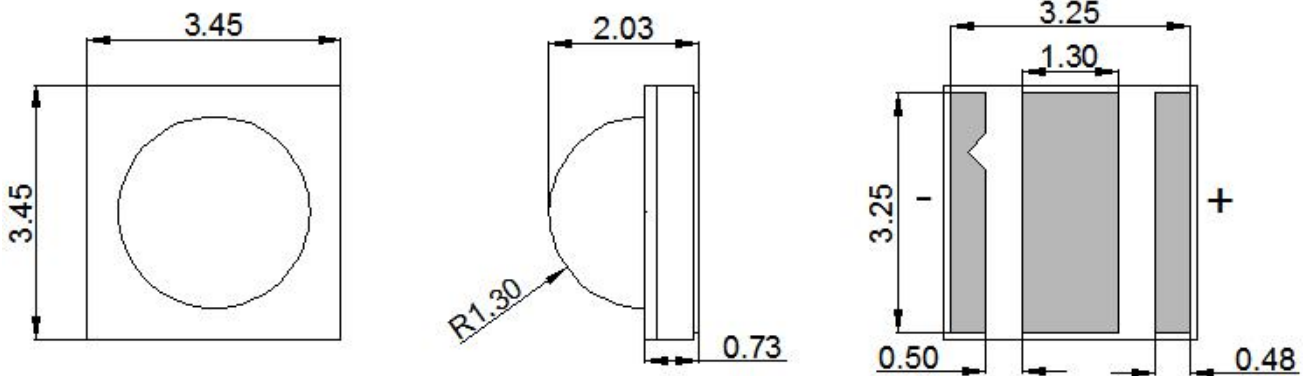
亮度

VF

产品尺寸

单位: mm.

公差: ± 0.1

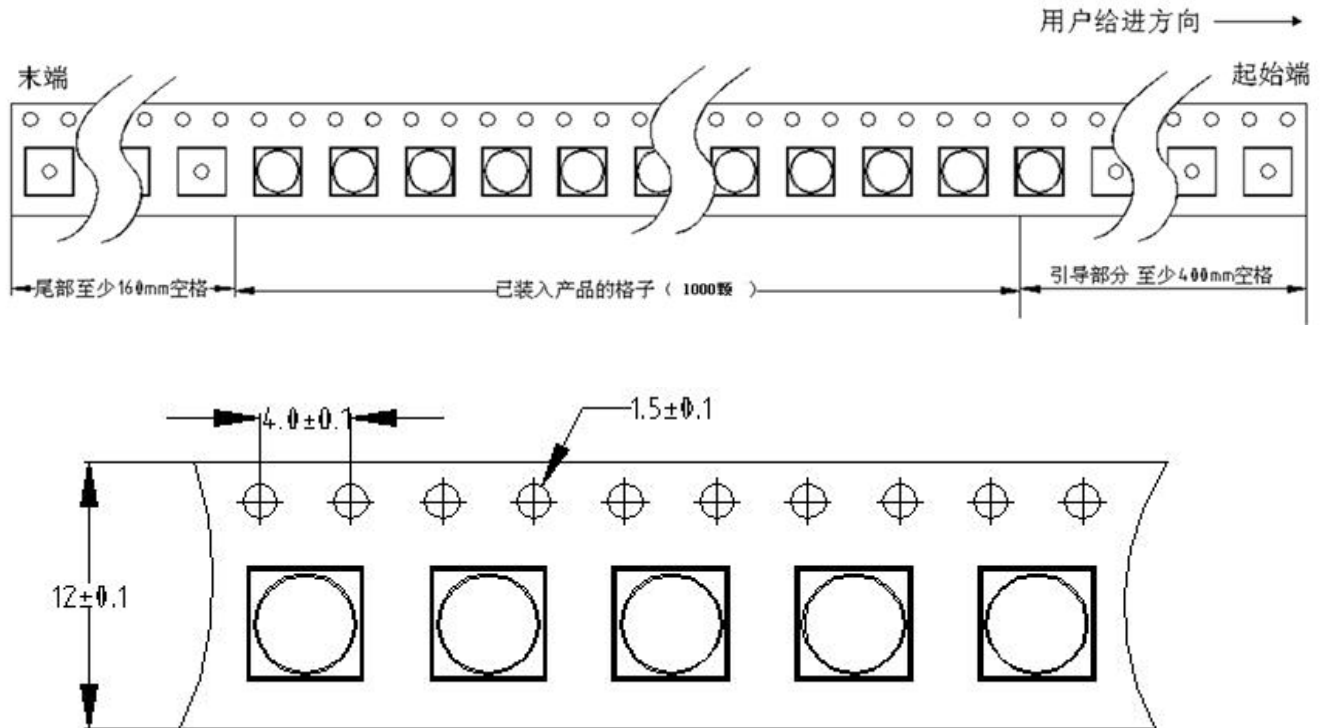


包装规格

包装方式：7 英寸卷盘包装 (包装数量：1200pcs)

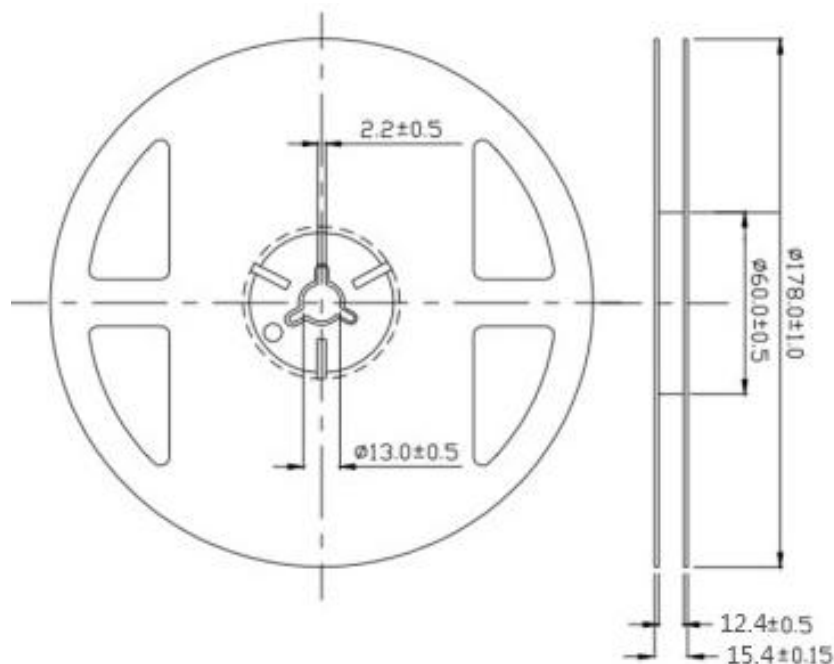
单位：mm

载带尺寸图

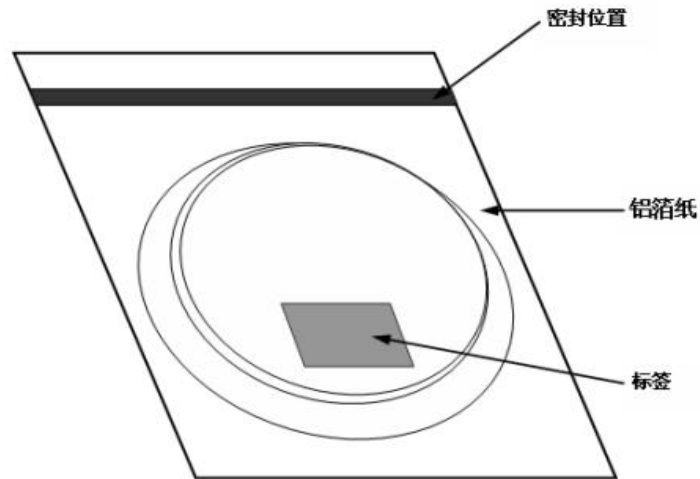


卷盘尺寸图

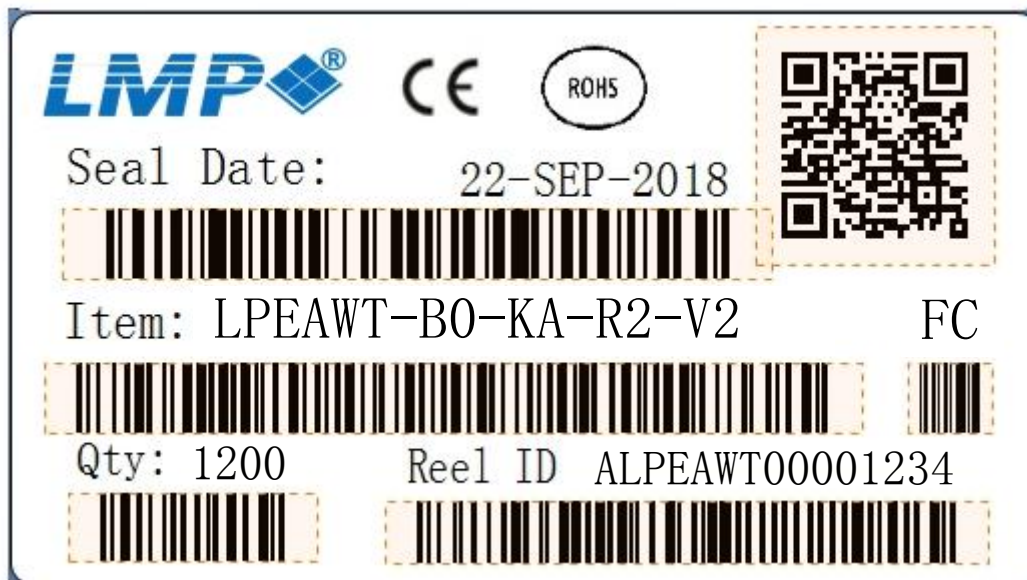
单位：mm



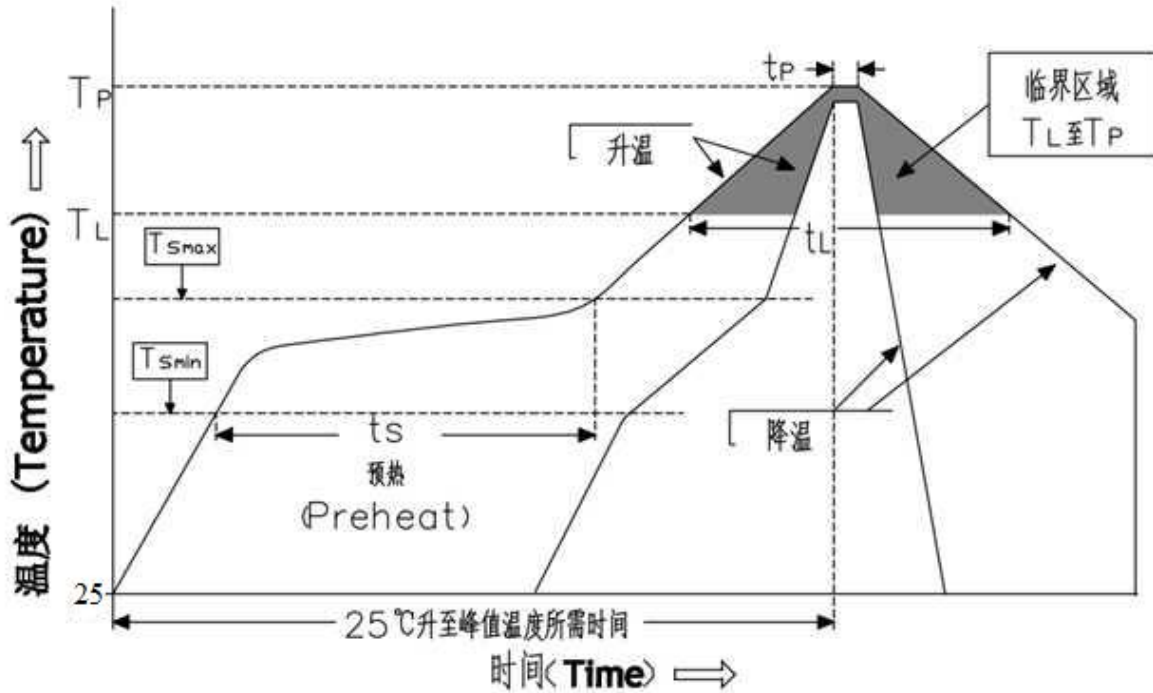
防潮包装



出货条码



回流焊升温曲线



分布特征	含铅回流焊	无铅回流焊
平均升温速度 ($T_{Smax}-T_p$)	3°C/second max.	3°C/second max.
最低预热温度 (T_{Smin})	100°C	150°C
最高预热温度 (T_{Smax})	150°C	200°C
预热时间 ($t_{Smin}-t_{Smax}$)	60~120 seconds	60~180 seconds
温度 (T_L)	183°C	217°C
维持在 T_L 以上的时间 (t_L)	60~150 seconds	60~150 seconds
峰值温度 (T_p)	215°C	260°C
维持与实际峰值温度相差在 5°C 以内的时间 (t_p)	10~30 seconds	20~40 seconds
降温速度	6°C/second max.	6°C/second max.
从 25°C 升至峰值温度所需时间	6 minutes max.	8 minutes max.

备注:

1. 所有温度指封装表面温度，为封装体表面测定的数据；
2. 本回流焊曲线提供参考，并非适用于所有的 PCB 设计和回流焊设备；
3. 其他事项请参考《使用注意事项》。

使用注意事项

一、储存

1. 储存温度 5~30℃,相对湿度小于 28%。
2. 避免外力破坏真空包装袋,以防受潮。

二、使用

1. 正品锡膏,标准自动贴片机贴装。
2. 八温区以上回流焊,峰值温度小于 260℃,时间小于 10s。
3. 重复回流焊不超过 2 次。
4. 杜绝对灯珠施力受压,以免透镜刮伤、变形或脱落,造成死灯。
- 5 禁止使用有机溶剂或超声波。
- 6.焊接面空洞率小于 20%。
- 7.冷却后方能测试及使用。
- 8.做好静电防护。